



Advanced Packaging Conference

In conjunction with SEMICON Europa 2010

19-20 October, Dresden, Germany

The conference will give the opportunity to learn more about most important microelectronics applications developments which enable novel, advanced packaging solutions to be the key drivers in system integration of electronic devices. The presentations will shed light on recent application specific packaging technologies, processing and manufacturing related technologies, which can be leveraged as key enablers for cost efficient electronic devices and systems.

Tuesday 19 October 2010

- 13:30 Welcome
Andy Longford, Panda Europe, Co-chair of the SEMI Advanced Packaging Conference Committee

SESSION 1: Packaging for Systems

- 13:45 KEYNOTE: System Design, Drives Package Design, Drives Silicon Design, Peter Robinson, Package Design and Development Director, CSR
- 14:30 Modeling and Design of Electronic Packaging Structures for High-Density Integration and High-Speed Applications, Ivan Ndip, Group Manager of RF & High-speed System Design, Fraunhofer IZM Berlin
- 15:00 Successful Package Development and Manufacturing of an Automotive Oil Level Sensor System, Ignas van Dommelen, Director of Development, Marketing & Sales, Elmos Advanced Packaging
- 15:30 Rapid Design for Manufacturability and Reliability by Virtual Prototyping, Sven Rzepka, Deputy Department Chair, Group Manager Micro Materials Center (MMC)
- 16:00 Coffee Break + Poster display

SESSION 2: Alternative Device Packaging. Session-chair: Andreas Dill, Oerlikon

- 16:45 KEYNOTE: High Brightness Phosphor Converted White LEDs – Challenges and Solutions, Raimund Schwarz, Senior Director, Osram Opto Semiconductors
- 17:30 Micro-Fabrication Enabled High-Bandwidth Packaging to 80 GHz, Sean Cahill, VP Technology, BridgeWave Communications
- 18:00 Trends in Sensor and MEMS Packaging, Caroline Beelen-Hendriks, Director Strategy for Package Innovation, NXP Semiconductors
- 18:30 End day 1
-

Wednesday 20 October 2010

SESSION 3: Embedded Wafer Level Packaging. Session-chair: Klaus Pressel, Infineon

- 9:00 eWLB Reconstitution – From Idea to Volume Production, Edward Fürgut, Infineon
- 9:30 Mechanical Deformation Effects in 300 mm Reconstructed eWLB Wafers, Eoin Otoole, Staff Integration Engineer, Nanium
- 10:10 The Evolution and Convergence of Advanced Fan Out Packaging in 2D and 3D Structures with Dissimilar Technologies for High Performance, Highly Integrated Systems, Navjot Chhabra, Redistributed Chip Packaging Manager, Packaging Solutions Development, Technology Solutions Organization, Freescale
- 10:30 Break + Poster Display

SESSION 4: Packaging & Materials. Session-chair: Graham Jones, Henkel

- 11:00 KEYNOTE: Substitute Material(s) for High-Lead Solders, Andreas Fischer, Automotive Electronics, Development ASIC & Power Packages, Robert Bosch GmbH
- 11:30 Polymeric Alternatives to Solder Die Attach for Power Assemblies, Günther Dreezen, Henkel Electronic Adhesives
- 12:00 Advanced PVD Solutions for Emerging 3D Wafer Packaging Applications, Patrick Carazzetti, Business Unit Systems, Oerlikon
- 12:30 A New Process for Building Coreless Substrates, Bernd Appelt, Director Worldwide Business Development, ASE – Advanced Semiconductor Engineering Group
- 13:00 End day 2

Register online at www.semiconuropa.org

Rückblick IMAPS Nordic Konferenz

6. bis 9. Juni 2010 Göteborg

IMAPS Nordic hat eine alte Tradition, die jährliche Konferenz in einem der vier skandinavischen Länder auszutragen. In diesem Jahr war Schweden an der Reihe und das an der Westküste gelegene Göteborg wurde als Location ausgewählt. Hier sind zahlreiche Unternehmen der Elektronikindustrie sowie Forschungseinrichtungen angesiedelt.

Das Programm war reichhaltig und eine gute Mischung aus lokalen sowie ausländischen Sprechern. Die Tatsache, dass die Veranstaltung mit einer Session ausgetragen wurde, erlaubte den Teilnehmern, alle Vorträge zu hören. Das Konferenzprogramm wurde mit den Keynote-Präsentationen von *Jean-Marc Yannou* über *3D packaging and IPDs* sowie *Bill Brox* über *Investing in intellectual assets* eröffnet.

Das reguläre Programm umfasste Themen von Flip Chip bis 3-D-Packaging. Die Präsentationen

deckten unter anderem Technologien wie LEDs, LED packaging, Klebstoffe und Encapsulants ab. Zuverlässigkeitsthemen wurden von *ELC* Präsident *Nihal Sinnadurai* und *Greg Caswell* vorgelesen. Das offizielle Programm endete mit einer Führung durch das *IMEGO Institut*, wo sich angewandte Forschung und neue Elektronikprodukte in enger Zusammenarbeit zwischen Industrie und F&E Instituten gegenseitig zu Neuem vorantreiben.

Am Mittwoch den 9. Juni fanden Tutorials mit der Hauptausrichtung Zuverlässigkeit statt. *Greg Caswell*, *DfR Solution* begann mit einem Tutorial über Reinheitsanforderungen in der SMT-Fertigung. Nach der Mittagspause brachte *Olli Salmela*, *Nokia Siemens Networks* das heiße Thema bleifreie Technologien auf die Tagesordnung.

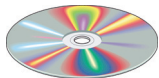
Im nächsten Jahr wird die Konferenz im Juni in Finnland stattfinden.

Veranstaltungskalender

Ort	Zeitraum	Name	Veranstalter
Berlin	13./16.9. 2010	3. Electronics Systems Integration Technology Conference	IEEE-CPMT
Wroclaw	22./25.9. 2010	Konferenz IMAPS Polen	IMAPS Poland
München	12./13.10. 2010	Herbstkonferenz	IMAPS Deutschland
Dresden	19./20.10. 2010	Advanced Packaging Conference bei SEMICON Europe 2010	SEMI, CPMT, IMAPS,
Raleigh	31.10./4.11.2010	43 th Symposium on Microelectronics	IMAPS NA

Noch zu haben: Proceedings

Die Proceedings der *IMAPS-Herbsttagung 2010*, die am 2. März in Ilmenau zum Thema *3D – mehr als nur die dritte Dimension?* stattgefunden hat, können auf CD zum Preis von



€ 55,-

und als Papierausdruck zum Preis von



€ 110,-

erworben werden.

Auch die Proceedings vorheriger *Herbsttagungen* und der *IMAPS-Seminare* zu Themen wie *Ist Zuverlässigkeit noch bezahlbar?* sind auf der CD enthalten und damit noch erhältlich.

Richten Sie bitte Ihre Bestellungen an:

Dipl.-Oec. Hans-Ulrich Knipps, c/o Hesse & Knipps GmbH, Vattmannstraße 6, D-33100 Paderborn, Fax: 05251/1560-97, hans-ulrich.knipps@imaps.de

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß § 4 Nr. 22 UstG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

Internet-Auftritt von IMAPS Deutschland

Sie finden die neu gestalteten Webseiten von *IMAPS Deutschland* im Internet unter

<http://www.imaps.de>

Hier erhalten Sie aktuelle Informationen über Veranstaltungen und Ansprechpartner von *IMAPS Deutschland e.V.* Darüber hinaus können Sie dort auch Ihre Mitgliedschaft beantragen. Über Kritik und Anregungen, aber auch inhaltlichen Input würde sich der Vorstand sehr freuen.

Die internationalen Seiten von *IMAPS* erreichen Sie unter

<http://www.imaps.org>

oder für Europa:

<http://www.imapseurope.org>

Impressum

IMAPS Deutschland e.V.

1. Vorsitzender:

Dr.-Ing. Martin Schneider-Ramelow

martin.schneider-ramelow@izm.fraunhofer.de

Schatzmeister

(bei Fragen zu Mitgliedschaft und Beitrag):

Dipl.-Oec. Hans-Ulrich Knipps

hans-ulrich.knipps@imaps.de

Ausführliche Kontaktinformationen zu den Vorstandsmitgliedern findet man unter www.imaps.de (*Vorstand*)